

预订2023上海半导体展-11月上海半导体展

产品名称	预订2023上海半导体展-11月上海半导体展
公司名称	FCE展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	15989233176

产品详情

2023上海国际半导体展

2023 Shanghai International Semiconductor Expo

时间：2023年11月22-24日

地点：上海新国际博览中心

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

支持单位

中华人民共和国工业和信息化部

中华人民共和国商务部

主办单位

中国电子器材有限公司

中电会展与信息传播有限公司

协办单位

中国电子元件行业协会

中国电子仪器行业协会

中国电子专用设备工业协会

中国电子制造产业联盟

上海市集成电路行业协会

上海市汽车工程学会

江苏省汽车工程学会

浙江省汽车工程学会

安徽省汽车工程学会

福建省物联网产业联盟

广东省未来通信高端器件创新中心

组织单位

广州一流展览服务有限公司

展会介绍

随着智能手机、人工智能、AIoT、智能汽车等新技术的快速发展，物联网应用逐渐规模化落地，安防由高清化向智能化的演进，新能源乘用车等众多行业的兴起，推动了对于半导体需求的持续快速增长，为全球半导体行业增添了新的动力。作为全球电子制造业的中心以及全球大的消费电子市场，近年来中国半导体产业也是增长迅速，中国已经成为全球大和贸易活跃的半导体市场。再加上中国政府对于半导体行业的大力扶持，中国半导体行业发展呈加速态势。“十四五”期间，我国半导体产业将有更全面的发展，并将加快高端芯片设计等领域关键核心技术的突破和应用。随着中国对5G、AI、IoT和云计算、大数据等技术的大量投资，以5G网络、工业互/物联网等为代表的“新基建”将带动半导体产业的高速增长。据预测，到2030年我国的半导体市场供应将达到5385亿美元，依然为全球大，69%的消费量将来自中国本土公司，需求主要来自数据中心、消费电子、汽车、医疗等应用领域。

为促进半导体行业新技术、新材料、新工艺及新装备的推广应用与经贸交流，推动半导体产业升级，2023上海国际半导体展将于2023年11月22-24日在上海新国际博览中心盛大举办，展会隶属于第102届中国(上海)电子展专题展之一，专注于整合半导体行业创新产品、技术、解决方案及商业合作模式的发掘，为半导体企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案平台，助力企业实现全产业链的交流和互通。作为兼具规模和影响力的半导体产业品牌盛会，展会遵循市场发展趋势，给国内外半导体行业创造提升品牌度和开拓市场的一个契机。充分发挥其传递市场信息与交流技术的窗口作用，把脉行业发展方向。共享国际化大平台，共拓半导体大市场，让我们携手同行，共创商机。

展会亮点

中国电子展(CEF)，以国产替代为牵引、以专精特新为动能，推动高质量创新发展

电子是支撑信息技术产业发展的基石，也是保障产业链供应链安全稳定的关键。中国制造业发展进入新时代，由高速发展转到高质量发展，核心技术自主创新、积极引导中小企业向精细化、特色化、新颖化发展是我国高质量发展的重要内容。中国电子展将以“创新强基、应用强链”为主题，继续以电子为技术牵引，拓展物联网、智能制造、5G、军工、新能源汽车、大数据、人工智能、信息安全等核心技术的应用创新，为产业发展助力，为企业腾飞加油。

上海，增强电子信息产业全链聚合发展能力，建设电子信息产业发展高地

上海与长三角各地产业协同发展，到2025年，初步建成具有全球影响力和竞争力的电子信息产业集群。产业链稳定性和韧性显著增强；新业态新模式持续涌现，电子信息产业对上海城市数字化转型、高质量发展的支撑赋能作用显著增强。十四五期间，重点提出构建“一核三基四前五端”产业体系，以集成电路为核心先导，突破核心基础元器件技术，聚焦下一代汽车电子、物联网、智能终端、智能传感等领域，不断完善行业发展生态。

展品范围

IC设计：IC及相关电子产品设计、IC产品与应用技术、IC测试方法与测试仪器、IC设计与设计工具、IC制造与封装、EDA、IP设计、嵌入式软件、数字电路设计、模拟与混合信号电路设计、集成电路布局设计、IDM、Fabless厂等；

芯片：人工智能芯片及方案、电源管理芯片、物联网芯片、5G通信芯片及方案、汽车电子芯片、安全控制芯片、数模混合通讯射频芯片、存储芯片、LED照明及显示驱动类芯片等；

晶圆制造及封装：晶圆制造、SiP先进封装、OSATs、EMS、OEMs、IDM、硅晶圆及IC封装载板、印制电路板、封装基板及设备以及组装和测试等、封装设计、测试、设备与应用制造与封测、EDA、MCU、印制电路板、封装基板半导体材料与设备等；

集成电路制造：晶圆制造厂、晶圆代工厂、模拟集成电路、数字集成电路和数、模混合集成电路制造、集成电路终端产品等；

半导体设备制造：封装设备、扩散设备、焊接设备、清洗设备、测试设备、制冷设备、氧化设备、减薄机、划片机、贴片机、单晶炉、氧化炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、抛光机、倒角机、离子注入设备、CVD/PVD设备、涂胶/显影机、前道测试设备、湿制程设备、热加工、涂布设备、单晶片沉积系统、固晶机、等离子清洗设备、切割机、装片机、键合机、焊线机、塑封机、回流焊、波峰焊、测试机、打弯设备、分选机、机器人自动化、机器视觉、其他材料和电子专用设备、耦合机、载带成型机、检测设备、恒温恒湿试验箱、传感器、封装模具、测试治具、精密滑台、步进电机、阀门、探针台、洁净室设备、水处理等；

封装与测试配套：测试探针台、探针卡、测试机、分选机、封装设备、封装基板、引线框架键合丝、引线键合、烧焊测试、自动化测试、激光切割及其它、研磨液、划片液、封片膜（胶）高温胶带、层压基板、贴片胶、上料板、焊线量控制、石英石墨、碳化硅等；

第三代半导体：第三代半导体碳化硅SiC、氮化镓GaN、晶圆、衬底、封装、测试、光电子器件(发光二极管LED、激光器LD、探测器紫外)、电力电子器件(二极管、MOSFET、JFET、BJT、IGBT、GTO、ETO、SBD、HEMT等)、微波射频器件(HEMT、MMIC)等；

半导体材料：硅片及硅基材料、硅晶圆、硅晶片、单晶硅、硅片、锗硅材料、S01材料、太阳能电池用硅材料及化合物半导体材料、石英制品、石墨制品、防静电材料、光刻胶及其配套试剂、晶圆胶带、光掩模版、电子气体、特种化学气体、CMP抛光材料、封装基板、引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘合材料、光阻材料、湿电子化学品、溅射靶材、封测材料、切片、磨片、抛光片、薄膜等；

AI+5G：人工智能、5G开发及应用、5G手机、5G通信(方案、设备、元器件、新材料、应用等)、智慧物联、物联网、智能安全、智慧城市、智能汽车、无人驾驶、智能传感、光电产业、智慧医疗、VR/AR、无线充电、屏下指纹、生物识别、工业互联网、智慧工厂、智能机器人、智能手机、智能交通、航天航空电子、智能家电、智能电视、智能家居、智能触控、智能穿戴、无人机、多接入边缘计算、网络切片、虚拟技术、医疗电子等；

Mini/Micro-LED：OLED显示屏、AMOLED显示屏、Micro-LED显示屏、Mini-LED显示屏片、驱动芯

片、封装材料、蚀刻设备、剥离设备、检测设备、测试仪、光谱分析仪、测量设备、封装设备、巨量转移、喷涂设备；MovVD设备、液相外镀炉、返修台、光刻机、划片机、全自动固晶机、金丝球焊机、硅铝丝超声压焊机、灌胶机、真空烘箱、芯片计数仪、芯片检测仪、倒膜机、光色点全自动分选机等。

电子元器件：电阻、电容器、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件/IGBT、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器、印制电路板、集成电路、各类电路、压电、晶体、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子功能工艺专用材料、电子胶(带)制品、电子化学材料及部品、无源器件、5G核心元器件特种电子、元器件、电源管理、储存器、连接器、线缆、接插器件、晶振、电阻、电位器磁性元件、滤波元件、PCB板、电机风扇、电声器件、显示器件、二极管、三极管滤波元件、开关及元器件材料及设备等；

智慧电源：微波射频、半导体LED、离子电源、共享智慧充电、通信电源、光伏/风电/储能电源设计、功率变换器磁技术等；

综合：全国各地政府组团、半导体相关领域高科技产业园区、证券、银行、保险、基金、投资金融机构等。

欢迎业界同仁踊跃报名参展CEF

2023，现正接受申请，请速与我们联系索取参展合同及展位平面图，巩固您的市场地位！

知识科普：

相比于其他种类的芯片设计，关于FPGA芯片通常需要设置较高门槛并且拟定严格性较强的基本设计流程。具体在设计时，应当紧密结合FPGA的有关原理图，据此实现了规模较大的专门芯片设计。通过运用Matlab以及C语言的特殊设计算法，应当可以实现全方位的顺利转化，从而确保其符合当前的主流芯片设计思路。在此前提下，如果选择了上述设计思路那么通常需要着眼于有序整合各类元器件以及相应的设计语言，据此保证了可用性与可读性较强的芯片程序设计。运用FPGA可以实现板机调试、代码仿真与其他有关的设计操作，确保当前的代码编写方式以及设计方案都能符合特定的设计需求。

除此以外，关于设计算法应当将合理性置于首要性的位置，据此实现了优化的项目设计效果，并且优化了芯片运行的实效性。因此作为设计人员来讲，首先就是要构建特定的算法模块，以此来完成与之有关的芯片代码设计。这是由于预先设计代码有助保证算法可靠性，对于整体上的芯片设计效果也能予以显著优化。在全面完成板机调试以及仿真测试的前提下，应当可以在根源上缩短设计整个芯片消耗的周期，同时也致力于优化当前现存的硬件整体结构。例如在涉及到开发非标准的某些硬件接口时，通常都会用到上述的新产品设计模式。